

**ST 706**

Entlöten von SMDs, ST 706 Halter für Entlötlingen RB 641
Einfache Handhabung - anwenderfreundliches und zeitsparendes
Arbeiten beim Entlöten von SOP's, QFP's, PLCC's, etc.

Desoldering of SMDs, ST 706 Shim blade holder for RB 641
Simple Operation - userfriendly and time saving working of
desoldering from SOP's, QFP's, PLCC's, etc.



ST 706

Nach Entfernen des Klingenschutzes schneiden Sie sich bitte die Entlötlinge mit einer Haushaltsschere entsprechend dem Bauteil und dem Platz auf der Leiterplatte zu. Hier zeigen wir Ihnen einige Formenbeispiele der Entlötlinge.

Vergewissern Sie sich, daß die Kanten der Entlötlinge vor Gebrauch glatt sind.



Schieben Sie die Entlötlinge unter eine Ecke des Bauteils und schmelzen Sie gleichzeitig mit dem Heißluftgerät das Lot.

Wenn Sie so alle 4 Seiten des PLCC entlötet haben, können Sie das Bauteil einfach abnehmen.



Bauteile, die zusätzlich mit einem Spezialkleber auf der Platine befestigt sind, entlöten Sie wie soeben beschrieben. Erwärmten Sie dann das Bauteil mit der Heißluft von oben. Schieben Sie, sobald der Kleber sich durch die Wärme löst, die Entlötlinge unter das Bauteil und heben es ab.



Sollte die Entlötlinge durch Flußmittelreste verklebt sein, ersetzen Sie diese durch eine neue.



Entnehmen Sie der Rolle RB 641 ein ca. 4 cm langes Stahlblättchen. Schneiden Sie es mit einer haushaltsüblichen Schere ab und zu.

After removal of the blade protection you can cut the desoldering blade with a kitchen scissors in a form according to the component and the design of the PCB. Here we show you some possibilities.
Assure that there are no sharp edges.



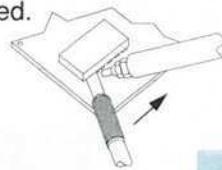
Slide the shim blade under one of the edges of the component and melt at the same time the solder joint with your hot air tool. After desoldering all 4 sides of the PLCC you are able to pick up the component.

Components which have been fixed additional on the PCB with a special glue, you can desolder in the same procedure. Additional you heat up direct the component from above. As soon as the glue gets liquid slide the shim blade between component and PCB and remove the component.

If the shim blade will be glued with flux residues, replace it through a new one.



Take from the roll RB 641 abt 4 cm shim blade and cut it with a scissors. Cut it into the required design as we have described.





WS 630

Entlöten von SMT-Bauteilen, Anwendung WS 630

Einfache Handhabung - anwenderfreundliches und zeitsparendes Arbeiten beim Entlöten von SOP's, QFP's, PLCC's, etc.

Desoldering of SMDs, Using of WS 630

Simple Operation - userfriendly and time saving working of desoldering from SOP's, QFP's, PLCC's, etc.

Mit Hilfe des Entlötdrahtes WS 630 können unterschiedlichste SMD-Bauteile / ICs mit Heißluft ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Spezialdüsen entlötet werden. Die Handhabung hierfür ist sehr einfach:

Führen Sie den Entlötdraht unter die Beinchenreihe so durch, daß Sie den Entlötdraht an beiden Enden fassen können.

Erwärmen Sie zunächst das Bauteil in kreisenden Bewegungen. Halten Sie das Heißluftgerät mit der Heißluftdüse so, daß der Luftstrom immer senkrecht auf das Bauteil geführt wird.

Führen Sie nun das Heißluftgerät einige Male um das Bauteil direkt auf die Pads.

Erwärmen Sie die Beinchenreihe, unter der der Entlötdraht liegt, indem Sie den Heißluft-Luftstrom immer wieder hin und her führen.

Sobald das Lot in seine liquide Form übergeht, können Sie vorsichtig den Entlötdraht zwischen Pads und Bauteilbeinchen unter dem Bauteil vorziehen. Biegen Sie hierbei die Beinchen nach oben.

Entlöten Sie auf die gleiche Art und Weise die anderen Seiten des Bauteils.



WS 630

With the usage of the pull wire WS 630 you can desolder different SMDs / ICs with hot air and without further tools or special tips. The operation is very easy:

Push the pull wire under one side of the IC legs, that you can hold both ends of the pull wire.

Heat up the component in circling movements. Hold the hot air tool with the hot air tip in a position, that the air flow is vertical to the SMT component.

Now warm up the pads in circelling movement around the component several times.

Heat up one side of the legs where you have positioned the pull wire with moving back and forth the hot air flow.

As soon as the solder gets liquid, carefully pull the desoldering wire up between the pads and the legs, so that you can bent the legs up.

Desolder in the same manner the other sides of the SMT component.

